

证券代码： 003031

证券简称： 中瓷电子

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

2026-003 号

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券 郭柯宇 新华基金 刘海彬 浙商证券 徐菲 中信建投 王大林 国信军工 李聪 中信建投 樊文辉 泉果基金 王苏欣 民生加银基金 郭丰睿 国新投资 李缙紫 华福证券 霍晓飞 国泰海通 黄龙 国泰海通 余伟民 国泰海通 戴鹏程 华福证券 张习方 金鹰基金 许中雅 宁波宝隼资产 王一达 兴银理财 江耀堃 长盛基金 滕光耀 神农投资 汪洋 中信建投 张玉龙 中信建投 赵子鹏 中信建投 辛侠平 兴业证券 章林 交银施罗德基金 李震琦 望正资产投资 旷斌 招商证券 李哲瀚 北京隆翔基金 何彦松 国泰海通 夏凡 国泰海通 夏国彬 景元投资 张轶乾 华福证券 魏征宇 民生加银基金 范明月 上海兆顺基金 钱之皓 源峰基金 陈俊 深圳清华大学研究院 舒彬 陈小华 摩根士丹利基金 雷志勇
时间	2026年5月8日--5月9日
地点	河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
上市公司接待人	1. 中瓷电子 常务副总经理（代总经理） 梁向阳

<p>员姓名</p>	<p>2. 中瓷电子 副总经理、财务总监、董事会秘书 董惠 3. 中瓷电子证券部工作人员</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p><b>1.请介绍公司电子陶瓷板块 2025 年整体经营及 2026 年一季度经营表现？</b></p> <p>全球新一轮 AI 技术爆发带动算力需求激增，直接拉动了数据中心建设和升级，从而对光模块产生了爆炸性需求。作为光模块封装关键材料，陶瓷外壳和基板市场需求快速增长，特别是氮化铝薄膜基板作为低成本非气密封装方案的关键封装材料呈现供不应求的情况。2026 年一季度受益 AI 算力、高端光通信行业高景气，光模块用陶瓷外壳、陶瓷基板订单大幅放量，产能利用率维持高位，电子陶瓷板块实现营收和利润同比大幅增长，是公司当期业绩增长的核心支撑板块之一。</p> <p><b>2.公司 2025 年经营现金流大幅改善，2026 年一季度现金流表现如何？</b></p> <p>2025 年经营活动现金流量净额 9.52 亿元，同比增长 75.77%，主要是加强销售回款管理、存货周转优化。2026 年一季度经营活动现金流量净额 3.77 亿元，同比增长 101.38%。详见巨潮资讯网 2026 年第一季度报告。</p> <p><b>3.本次收购雄安太芯 100% 股权的核心考量是什么？</b></p> <p>本次收购一是可以进一步扩充公司射频产品线，业务具有互补效应，二是高频封装与高频芯片设计处于产业链上下游，业务具有协同效应，三是可以更好地匹配所在行业变化及市场需求，提高募投资金使用效率，有利于防范投资风险、保障资源效益和投资收益。</p> <p><b>4.新增“高精密电子陶瓷生产线扩建项目”的必要性与前景如何？</b></p> <p>该项目涉及的氮化铝薄膜基板、通信器件用电子陶瓷外壳、精密陶瓷零部件产品是国家重点支持的民品产业之一。项目</p>

建设符合国家、河北省、石家庄市及中国电子科技集团公司发展规划和产业政策要求，建设机构完备，资金落实，建设条件满足石家庄市鹿泉区政府要求，相关手续齐全、配套条件具备。同时，高精密电子陶瓷生产线扩建项目涉及的产品均采用公司自主知识产权的材料、设计、工艺等核心技术，利用原有成熟多层陶瓷制备工艺，进行生产线扩建。相关产品已经在国内多家大客户处验证通过，并批量供货。中瓷电子在电子陶瓷外壳产品技术方面国内领先，相关产品性能与国际大公司同类产品相当，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备、低空经济等领域。

#### **5. 本次募投项目调整对公司未来业绩有何影响？**

本次将部分结余募集资金用于收购雄安太芯 100%股权，一定程度上保障了募投项目的实施效益，从而提高募投资金使用效率，有利于防范投资风险、保障资源效益和投资收益。雄安太芯主要围绕新兴产业应用，基于国产化化合物半导体工艺，专业从事太赫兹芯片设计及应用工作。本次交易完成后，雄安太芯的高频芯片业务可以很大程度上拓展公司当前射频芯片的工作频率和应用领域，扩充公司射频产品线，巩固公司在化合物射频芯片行业的优势地位，进一步增强上市公司半导体领域科技创新与产业协同，同时减少关联交易。本次交易完成后，雄安太芯将纳入上市公司合并报表，增强上市公司盈利能力和资产规模，上市公司的产业谱系进一步完善、市场领域进一步拓展，形成新的增长亮点，有利于促进国有资产保值增值，促进上市高质量发展。

新增募投项目“高精密电子陶瓷生产线扩建项目”涉及的氮化铝薄厚膜基板、通信器件用电子陶瓷外壳、精密陶瓷零部件产品均采用公司自主知识产权的材料、设计、工艺等核心技术，利用原有成熟多层陶瓷制备工艺，进行生产线扩建。相关产品已经在国内多家大客户处验证通过，并批量供货。新增产能将支撑公司在高增长领域的份额提升，整体有利于优化资产结构、提升盈

利能力与核心竞争力，为公司持续增长提供动力。

**6. 公司在半导体设备用精密陶瓷领域 2025 年及 2026 年一季度有哪些突破？**

公司持续加大精密陶瓷零部件领域的研发和投入力度，已开发了氧化铝、氮化铝精密陶瓷零部件产品，建立了精密陶瓷零部件制造工艺平台，开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证，已批量应用于国产半导体设备中，静电卡盘产品已经通过国内头部半导体设备公司上机验证，精密陶瓷零部件销售收入同比有大幅增长。

**7. 子公司博威公司 2025 年研发投入与核心技术突破有哪些？**

博威公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件以及微波点对点通信射频芯片与器件领域，突破了 IC 设计、封测制造、可靠性和质量控制等环节的一系列关键核心技术，拥有自主知识产权，实现产品系列化开发和产业化转化，产品指标和质量达到国内领先、国际先进水平。目前公司积极推进 5G-A、6G、卫星通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破、研发及产业化工作，储备关键技术和能力，根据用户需求，稳步推进产品规模化应用等工作。

**8. 子公司博威公司 2026 年业务发展重点与产能规划是什么？**

公司积极推进新一代移动通信射频芯片与器件关键技术突破和产品研发与产业化工作，在氮化镓通信基站射频芯片与器件以及微波点对点通信射频芯片与器件领域，持续推进新一代产品系列化开发和产业化转化工作；同时，围绕 5G-A/6G 通信、卫星通信射频芯片与器件，低空经济、固态射频源等领域，储备关键技术，稳步推进产品开发和产业化布局工作。

**9. 子公司国联万众 SiC 芯片与模块的核心产品布局及 2025—2026 年进展？**

国联万众 SiC 芯片与模块的核心产品，650V~2300V 均有成

	<p>熟系列产品且已批量出货，3300V 有样品提供给客户进行试用，6500V 及以上电压的产品在研制过程中。</p> <p>2025 年，公司完成工艺线升级由 6 英寸升级为 8 英寸，完成 H4M 工艺平台开发，产品性能和可靠性进一步提升，多款产品可靠性测试通过 AEC-Q101 标准；2026 年将完成 8 英寸 H5M 的工艺开发，产品性能将进一步提升。同时，产线良率将持续提升。</p> <p><b>10. 子公司国联万众在新能源汽车领域的客户拓展与应用进展？</b></p> <p>国联万众在 800V 高压新能源车方面已与四家新能源汽车展开积极合作，已进行多轮的产品迭代测试，部分型号完成了上车的冬测。</p> <p><b>11. 2026 年公司业务发展的核心目标与战略重点是什么？</b></p> <p>2026 年核心目标是巩固电子陶瓷龙头地位，加速第三代半导体业务放量，拓展新兴领域，实现业绩持续增长。</p> <p>战略重点：1、光模块陶瓷领域持续聚焦 AI 算力、高端光通信行业高景气，持续提升高端产品占比；2、第三代半导体领域持续扩大 GaN 射频、SiC 功率市场份额；3、半导体精密陶瓷零部件等领域加速实现批量稳定供货；4、持续进行研发投入，强化技术领先，提升公司整体竞争力。</p> <p><b>风险提示：</b></p> <p>二级市场股价受行业、宏观经济环境、投资者价值判断及资本市场整体状况等多方面因素共同影响，请投资者谨慎判断，注意投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026-5-9